

元大證券股份有限公司等包銷力晶積成電子製造股份有限公司 初次上市前公開承銷之普通股股票銷售辦法公告 股票代號：6770

(本案公開申購係預扣價款，並適用掛牌後首五交易日無漲跌幅限制之規定，投資申購前應審慎評估)
(本案投標人需繳交投標保證金，如得標後不履行繳款義務者，除喪失得標資格外，證券承銷商就投標保證金應沒入之)

元大證券股份有限公司等共同辦理力晶積成電子製造股份有限公司（以下簡稱力積電公司或該公司）普通股股票初次上市承銷案(以下簡稱本次承銷案)公開銷售之總股數為 120,500 仟股對外辦理公開銷售，其中 88,400 仟股以競價拍賣方式為之，業已於 110 年 11 月 22 日完成競價拍賣作業，22,100 仟股則以公開申購配售辦理，依「證券承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，由力積電公司協調其股東提供已發行普通股 10,000 仟股，供主辦承銷商採公開申購方式進行過額配售，其實際過額配售數量視中籤數量認定。

茲將銷售辦法公告於後：

一、承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商採競價拍賣、公開申購配售及過額配售數量：

承銷商名稱	地址	過額配售股數	競價拍賣包銷股數	公開申購包銷股數	總承銷股數
主辦承銷商：					
元大證券股份有限公司	臺北市敦化南路一段 66 號 11 樓	10,000 仟股	82,250 仟股	15,950 仟股	108,200 仟股
協辦承銷商：					
兆豐證券股份有限公司	臺北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	-	1,150 仟股	1,150 仟股	2,300 仟股
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松山區民生東路三段 156 號 11 樓	-	1,150 仟股	1,150 仟股	2,300 仟股
華南永昌綜合證券股份有限公司	臺北市民生東路四段 54 號 5 樓	-	1,150 仟股	1,150 仟股	2,300 仟股
第一金證券股份有限公司	台北市中山區長安東路一段 22 號 10 樓	-	1,050 仟股	1,050 仟股	2,100 仟股
元富證券股份有限公司	臺北市敦化南路二段 97 號 22 樓	-	500 仟股	500 仟股	1,000 仟股
台新綜合證券股份有限公司	台北市建國北路一段 96 號 12 樓	-	500 仟股	500 仟股	1,000 仟股
台灣土地銀行股份有限公司	臺北市中正區延平南路 81 號	-	250 仟股	250 仟股	500 仟股
合作金庫證券股份有限公司	臺北市松山區長安東路二段 225 號 C 棟 6 樓	-	250 仟股	250 仟股	500 仟股
彰化商業銀行股份有限公司	臺北市中山區中山北路二段 57 號 8 樓	-	150 仟股	150 仟股	300 仟股
合計		10,000 仟股	88,400 仟股	22,100 仟股	120,500 仟股

二、承銷價格：每股新台幣 49.88 元整(每股面額新台幣壹拾元整)

三、本案適用掛牌後首五交易日無漲跌幅限制之規定，投資人應注意交易之風險。

四、初次上市承銷案件，主辦承銷商執行過額配售及價格穩定措施之相關資訊及發行公司股東自願送存集保股份佔上市掛牌資本額之比例及自願送存集保期間：

- (一)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，主辦證券商已與力積電公司簽定「過額配售及特定股東鎖定期協議書」，由力積電公司協調其股東提出對外公開銷售股數之 9.05%，計 10,000 仟股已發行普通股股票供主辦證券承銷商進行過額配售，主辦承銷商負責規劃及執行穩定價格操作，以穩定承銷價格。
- (二)特定股東限制：依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，主辦證券承銷商已與力積電公司簽定「過額配售協議書」，依規定提出強制集保股份合計 970,750,379 股，分別占申請上市掛牌股數總額 3,405,196,242 股之 28.50%，以及上市掛牌時擬發行股份總額 3,535,196,242 股之 27.46%。

五、初次上市承銷案件，是否因公開申購配售之申購狀況而調整詢價團購、公開申購配售數量之情事者，應予以揭露：不適用。

六、公開申購及過額配售投資人資格及事前應辦事項：

(一)公開申購投資人資格：

1. 申購人應為中華民國國民。
2. 申購人應於往來證券經紀商開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶及集中保管帳戶。
3. 申購人應洽往來證券經紀商辦理與指定之銀行簽訂委託書，同意銀行未來申購截止日止，自動執行扣繳申購處理費二十元、認購價款、中籤通知郵寄工本費五十元之手續。

(二)如有辦理過額配售者，資格同本公告第六條(一)公開申購投資人資格辦理。

七、競價拍賣、公開申購及過額配售之數量限制：

- (一)競價拍賣數量：競價拍賣最低每標單位為 1 張(仟股)，每一投標單最高投標數量不超過 12,050 張(仟股)，每一投標人最高得標數量不得超過 12,050 張(仟股)，投標數量以 1 張(仟股)之整倍數為投標單位。
- (二)公開申購數量：每查銷售單位為 1 仟股，每人限購 1 單位(若超過壹申購單位，即全數取消申購資格)。
- (三)過額配售數量：過額配售數量為 10,000 仟股，該過額配售部分，採公開申購方式辦理，並依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第十七條及第十八條規定訂定承銷價格。
- (四)承銷商於辦理配售作業時，應依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理。

八、申購期間、申購手續及申購時應注意事項：

- (一)申購期間自 110 年 11 月 24 日起至 110 年 11 月 26 日止；申購處理費、中籤通知郵寄工本費及申購價款繳存往來銀行截止日為 110 年 11 月 26 日；申購處理費、中籤通知郵寄工本費及申購價款扣繳日為 110 年 11 月 29 日(扣繳時點以銀行實際作業為準)。
- (二)申購方式：於申購期間內之每一營業日上午九時至下午二時，以下列方式申購(除申購截止日外，申購人於申購期間內當日下午 2 時後始完成委託者，視為次一營業日之申購委託)。

- 1.電話申購：投資人可以電話向往來經紀商業務人員下單申購並由其代填申購，故雖未親自填寫，但視同同意申購委託書所載各款要項。
- 2.當面或網際網路申購：投資人應確實填寫申購委託書各項資料並簽名或蓋章，至往來經紀商當面向業務人員或於申購期間截止日前以網際網路申購，惟採網際網路時，申購者需自負其失誤風險，故申購人宜於網際網路申購後電話洽收件經紀商業務人員，以確保經紀商收到申購委託書。

- (三)申購人向證券經紀商投件申購後，申購委託書不得撤回或更改。
- (四)每件公開申購抽籤案件，每位申購人僅能向一家證券經紀商辦理申購，且以申購一件為限。重複申購者將被列為不合格件，取消申購資格。
- (五)申購人申購時，需確認申購截止日銀行存款餘額應有申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額供銀行執行扣款。如有數個有價證券承銷案於同一天截止申購，當申購人投件參與其中一個以上案件時，銀行存款之扣款應以所申購各案有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計總額為準，否則全數為不合格件。
- (六)為便於申購人查閱投件是否已被接受為合格件，收件經紀商於申購期間，每日將截至前一日止之初步合格及不合格申購資料(此時尚未驗證重複件，亦尚未執行款項扣繳)備置於營業廳，以供申購人查閱。
- (七)申購人申購後，往來銀行於扣繳日 110 年 11 月 29 日將辦理申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳事宜(扣繳時點以銀行實際作業為準)。如申購人此時銀行存款不足申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費三項總計之金額，將視為不合格件。
- (八)申購人之申購投件一旦被列為不合格件，則將取消申購資格，證券經紀商於公開抽籤日次一營業日上午十點前(110 年 12 月 1 日)，併同未中籤之申購人之退款作業，退還中籤通知郵寄工本費及申購有價證券價款(均不加計利息)，惟申購處理費不予退回。
- (九)申購人銀行存款不足同時支應投標保證金、投標處理費、得標價款、得標手續費、申購處理費、申購認購價款、中籤通知郵寄工本費及交易市場之交割價款時，應以交割價款為優先，次為得標價款及得標手續費，再為申購處理費、申購認購價款及中籤通知郵寄工本費，最後為投標保證金及投標處理費。

九、公開申購銷售處理方式及抽籤時間：

- (一)相關作業請參考「中華民國證券商業同業公會證券商辦理公開申購配售作業處理程序」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」。
- (二)證交所應於抽籤前，將銀行存款不足無法如期扣繳申購處理費、申購價款、中籤通知郵寄工本費之合計金額及重複申購之資料予以剔除，並應於申購截止日之次一營業日完成上述合格件及不合格件之篩選，重複申購者已扣繳之處理費不予退還，並由承銷商於承銷期間截止後一週內以掛號函件通知申購人。
- (三)如申購數量超過銷售數量時，則於 110 年 11 月 30 日上午九時起在台灣證券交易所電腦抽籤室(台北市信義路五段七號十樓)，以公開方式就合格件辦理電腦抽籤作業抽出中籤人，其方式依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷及再行銷售有價證券處理辦法」辦理，並由證交所邀請發行公司代表出席監督。

十、申購人經中籤後不能放棄認購及要求退還價款，申購前應審慎評估。

十一、通知及(扣)繳交價款日期與方式：

(一)競價拍賣部分：

1.得標人之得標價款及得標手續費繳存往來銀行截止日為 110 年 11 月 24 日止，得標人應繳足下列款項：

(1)得標價款：得標人應依其得標價款認購之，應繳之得標價款，應扣除已扣繳之投標保證金後為之。

(2)得標手續費：

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第十二條規定，承銷商得向得標人收取得標手續費。本次承銷案件得標人每一得標單應繳交得標價款之 5.0% 之得標手續費，並併同得標價款於銀行繳款截止日(110 年 11 月 24 日)前存入往來銀行。

每一得標單之得標手續費：每股得標價格 × 得標股數 × 5.0%。

(3)得標人得標價款及得標手續費扣繳日：110 年 11 月 25 日(依銀行實際之扣款作業為準)。

2.得標人未如期履行繳款義務時，除喪失得標資格外，投標保證金應由主辦承銷商沒入之，並依該得標人得標價款自行認購。

3.如有數個有價證券承銷案於同一天截止繳交得標價款及得標手續費，當投資人投標參與其中一個以上案件，或就同一競價拍賣案件有多筆得標單時，銀行存款之扣款應以已繳保證金較高者優先扣款，如金額相同者，以得標應繳價款及得標手續費合計總額較高者優先扣款，如金額相同者，以投標單輸入時間先後順序扣款。

4.未得標及不合格件保證金退款作業：經紀商業於開標日次一營業日(110 年 11 月 23 日)上午十點前，依證交所電腦資料，指示往來銀行將未得標(包括單一投標單部份未得標)及不合格件之保證金不加計利息予以退回，惟投標處理費不予退回。

(二)公開申購部份：

申購處理費、中籤通知郵寄工本費及申購價款扣繳日為 110 年 11 月 29 日(扣繳時點以銀行實際作業為準)。

(三)實際承銷價格(公開申購及過額配售價格)訂定之日期為 110 年 11 月 22 日，請於當日上午十時自行上網至台灣證券交易所網(<http://www.tse.com.tw>)免費查詢。

十二、未中籤人之退款作業：經紀商應於公開抽籤日次一營業日(110 年 12 月 1 日)上午十點前，依證交所電腦資料，指示往來銀行將未中籤之申購人之中籤通知郵寄工本費及申購有價證券價款均不加計利息予以退回，惟申購處理費不予退回。

十三、公開申購之中籤名冊及競價拍賣得標名單之查詢管道：

(一)公開申購：

1.可參加公開抽籤之合格清冊，將併同不合格清冊，於公開抽籤日，備置於收件經紀商(限所受申購部分)，台灣證券交易所股份有限公司及主辦承銷商營業處所，以供申購人查閱。

2.由承銷商於公開抽籤日次一營業日以限時掛號寄發中籤通知書及公開說明書等。

3.申購人可以向原投件證券經紀商查閱中籤資料，亦可以透過台灣集中保管結算所股份有限公司電話語音系統查詢是否中籤，但使用此系統前，申購人應先向證券經紀商申請查詢密碼，相關查詢事宜如后：

(1)當地電話號碼七碼或八碼地區(含金門)，請撥 412-1111 或 412-6666，撥通後再輸入服務代碼 111 #

(2)當地電話號碼六碼地區請撥 41-1111 或 41-6666，撥通後再輸入服務代碼 111 #

(3)中籤通知郵寄工本費每件 49.88 元整。

(二)競價拍賣：

開標日後，投標人可於「承銷有價證券競價拍賣系統」或向開戶證券經紀商查詢，亦可以透過臺灣集中保管結算所股份有限公司電話語音系統查詢是否得標，但使用此系統前，得標人應先向證券經紀商申請查詢密碼，相關查詢事宜如本公告十三、(一)3。

十四、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：

(一)力積電公司於股款募集完成後，通知集保結算所於 110 年 12 月 6 日將股票直接劃撥至認購人指定之集保帳戶，並於當日上市（實際上市日期以發行公司及臺灣證券交易所股份有限公司公告為準）。

(二)認購人帳號有誤或其他原因致無法以劃撥方式交付時，認購人須立即與所承購之承銷商辦理後續相關事宜。

十五、有價證券預定上市日期：110 年 12 月 6 日。

十六、投資人應詳閱本銷售辦法、公開說明書及相關財務資料，並對本普通股股票之投資風險自行審慎評估，力積電公司及各證券承銷商均未對本普通股股票上市後價格為任何聲明、保證或干涉，其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。如欲知其他財務資料可參閱公開資訊觀測站 (<http://www.mops.twse.com.tw>)或發行公司網址：<http://www.powerchip.com>。

十七、公開說明書之分送、揭露及取閱地點：

(一)有關該公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，投資人得上網至公開資訊觀測站網站查詢(<http://mops.twse.com.tw>—>基本資料—>電子書)，或至主、協辦證券承銷商網站免費查詢，網址：(元大證券股份有限公司(<https://www.yuanta.com.tw>)、兆豐證券股份有限公司(<https://www.emega.com.tw/>)、群益金鼎證券股份有限公司(<https://www.capital.com.tw/>)、華南永昌綜合證券股份有限公司(<https://www.entrust.com.tw/>)、第一金證券股份有限公司(<https://www.firstsec.com.tw/>)、元富證券股份有限公司(<https://www.masterlink.com.tw/>)、台新綜合證券股份有限公司(<https://www.tssco.com.tw/>)、台灣土地銀行股份有限公司(<https://www.landbank.com.tw/>)、合作金庫證券股份有限公司(<https://www.tcfhc-sec.com.tw/>)、及彰化商業銀行股份有限公司(<https://www.bankchb.com/>))。歡迎來函回郵四十一元之中型信封洽該公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段 97 號地下 2 樓)索取。

(二)競價拍賣開標後，承銷商應將「得標通知書」及「公開說明書」以限時掛號寄予得標投資人；另應於公開申購結束後，將「公開說明書」、「中籤通知書」以限時掛號寄發中籤人。

十八、財務報告如有不實，應由發行公司及簽證會計師依法負責。

十九、特別注意事項：

(一)認購人於認購後、有價證券發放前死亡者，其繼承人領取時，應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書，繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。

(二)申購人有左列各款情事之一者，經紀商不得受託申購，已受理者應予剔除：

- 1.於委託申購之經紀商未開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶者。
- 2.未與經紀商指定之往來銀行就公開申購相關款項扣繳事宜簽訂委託契約書。
- 3.未於規定期限內申購者。
- 4.申購委託書應填寫之各項資料未經填妥或資料不實者。
- 5.申購委託書未經簽名或蓋章者，惟以電話或網際網路委託者不在此限。
- 6.申購人款項劃撥銀行帳戶之存款餘額，低於所申購有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額者。
- 7.利用或冒用他人名義申購者。

(三)本次參與有價證券承銷申購之人，於中籤後發現有違反前述第(一)、(二)項之規定，應取消其認購資格者，其已扣繳認購有價證券款項應予退還；但已扣繳之申購處理費及中籤通知郵寄工本費不予退還。前項經取消認購資格之認購人及經取消認購資格之繼承人，欲要求退還已繳款項時，應憑認購人或其繼承人身分證正本(法人為營利事業登記證影本，未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人身分證正本代之)，洽原投件證券經紀商辦理。

(四)申購人可以影印或自行印製規格尺寸相當之申購委託書。

(五)申購人不得冒用或利用他人名義或偽編國民身分證字號參與。證券商經發現有冒用、利用他人名義或偽編國民身分證字號參與有價證券申購者，應取消其參與申購資格，處理費用不予退還；已認購者取消其認購資格；其已繳款項，不予退還。

(六)若於中籤後發現有中籤人未開立或事後註銷交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶情事，致後續作業無法執行者，應取消其認購資格。

(七)證券交易市場如因天然災害或其他原因致集中交易市場休市時，有關申購截止日、公開抽籤日、處理費、中籤通知郵寄工本費或價款之繳存、扣繳、解交、匯款等作業及其後續作業順延至次一營業日辦理；有關投標截止日、開標日、投標處理費、投標保證金、得標手續費、價款之繳存、扣繳、解交、匯款等作業，其後續作業一律順延至次一營業日辦理；另如係部份縣(市)停止上班，考量天災係不可抗力之事由，無法歸責證券商，投資人仍應注意相關之風險，如投標保證金及投標處理費扣款日遇部分縣(市)停止上班但集中市場未休市時，投標保證金及投標處理費之扣繳日及其後續之開標日、未得標或不合格件保證金退款日、得標剩餘款項及得標手續費繳存往來銀行截止日及扣繳日、經紀商價款解交日等均順延至次一營業日辦理。

二十、該股票奉准上市以後之價格，應由證券市場買賣雙方供需情況決定，承銷商及發行公司不予干涉。

二十一、會計師最近三年度及最近期財務資料之查核簽證意見：

年度	簽證會計師事務所	簽證會計師姓名	查核簽證意見
107	勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰、鍾鳴遠	無保留意見加其他事項段落
108	勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰、鍾鳴遠	無保留意見加其他事項段落

109	勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰、鍾鳴遠	無保留意見
110年第三季	勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰、鍾鳴遠	保留結論—非重要子公司之財務報表未經會計師核閱

二十二、承銷價格決定方式(如附件一)。

二十三、律師法律意見書要旨(如附件二)。

二十四、證券承銷商評估報告總結意見(如附件三)。

二十五、金融監督管理委員會或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無。

二十六、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：詳見公開說明書。

【附件一】股票承銷價格計算書

一、承銷總股數說明

- (一)力晶積成電子製造股份有限公司(以下簡稱力積電或該公司)股票初次申請上市時之實收資本額為新臺幣 34,051,962,420 元，每股面額新臺幣 10 元整，分為 3,405,196,242 股。該公司擬於股票初次申請上市案經主管機關審查通過後，提出 130,000,000 股之股數辦理現金增資發行新股，預計股票上市掛牌時已發行股數為 3,535,196,242 股及實收資本額為 35,351,962,420 元。
- (二)依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第十一條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第十七之一條規定，公開發行公司初次申請股票上市時，至少應提出擬上市股份總額百分之十之股份，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。但應提出承銷之股數超過二千萬股以上者，得以不低於二千萬股之股數辦理公開銷售。另若公開發行公司開始為興櫃股票櫃檯買賣未滿二年者，得扣除其前已依法提出供興櫃股票推薦證券商認購之股數，但扣除之股數不得逾提出承銷總股數之百分之三十。
- (三)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款規定，主辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數之百分之十五之額度(上限)，提供已發行普通股股票供主辦承銷商辦理過額配售；惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。
- (四)該公司截至截至 2021 年 9 月 30 日止，記名股東人數為 322,596 人，內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數為 322,567 人，所持股份為 2,424,979,352 股，合計持股占發行股份總額 71.21%，已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第五條有關股權分散之標準。
- (五)綜上所述，該公司依規定預計辦理現金增資發行新股 130,000,000 股，扣除依公司法規定保留百分之十五予員工優先認購之 19,500,000 股後，餘 110,500,000 股依據「證券交易法」第二十八之一條規定，經 2021 年 7 月 2 日股東會決議通過由原股東全數放棄認購以辦理上市前公開承銷作業，排除公司法第 267 條第三項原股東優先認購之適用。另本證券承銷商已與該公司簽訂過額配售協議，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數百分之十五之額度範圍內，供本證券承銷商辦理過額配售及價格穩定作業，屆時主辦承銷商與該公司再依市場需求決定實際過額配售數量。

二、承銷價格

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

1.承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

目前證券投資分析較常使用之股票價值評價方法主要包括市場法與成本法及收益法。各種方法皆有其優缺點，且採用方法不同，評估結果亦有所差異。其中，市場法包括本益比法(Price/Earnings ratio, P/E ratio)及股價淨值比法(Price/Book value ratio, P/B ratio)，皆係透過已公開的資訊，與整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，進行公司價值評估，再依被評價公司與採樣公司之差異，進行折溢價調整，作成公司價值之結論；成本法主係為淨值法，並以帳面歷史成本作為公司價值之評估基礎；收益法主係以未來利益流量(如：現金流量...等)作為公司價值之評估基礎。茲將市場法、成本法及收益法等計算方式、優缺點與適用時機整理列示如下：

方法	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
計算方式	依據公司之財務資料，計算每股帳面盈餘，並以上市櫃公司或產業性質相近的同業平均本益比評估價值，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	依據公司之財務資料，計算每股帳面淨值，比較上市櫃公司或產業性質相近的同業平均股價淨值比估算股價，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎，即以資產負債表帳面資產總額減去帳面負債總額，並考量資產及負債之市場價格而進行帳面價值之調整。	根據公司預估之獲利或現金流量，並以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，據以評估企業整體價值。
優點	1. 最具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據，具有相當之參考價值。 2. 所估算之價值與市場的股價較接近。 3. 較能反映市場、研判多空氣氛及投資價值認定。 4. 市場價格資料容易取得。	1. 淨值係長期且穩定之指標。 2. 當盈餘為負數時之替代評估方法。 3. 市場價格資料容易取得。	1. 評估資料取得容易。 2. 使用財務報表之資料，較客觀公正。	1. 符合學理上對價值的推論，能依不同關鍵變數的預期來評價公司。 2. 較不受會計原則或會計政策不同而影響。 3. 反應企業之永續經營價值，並考量企業之成長性及風險。

方法	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
缺點	1. 盈餘品質受會計方法之選擇所影響。 2. 即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。 3. 企業盈餘為負數時不適用。	1. 帳面價值受會計方法之選擇所影響。 2. 即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。	1. 資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2. 未考量公司經營成效之優劣。 3. 不同種類資產需使用不同分析方法，且部分資產價值計算較為困難。	1. 使用程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2. 對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3. 預測期間較長。
適用時機	1. 企業生命週期屬成長型公司。 2. 獲利型公司。	1. 有鉅額資產但股價偏低的公司。 2. 獲利波動幅度較大之公司。	1. 適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。 2. 虧損或營運衰退型公司。	1. 當可取得公司詳確的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2. 企業經營穩定，無鉅額資本支出。

上述股價評價之各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦多有差異，其中因現金流量折現法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，由於未來之現金流量無法精確掌握，且評價使用之相關參數之參考價值相對較低，國內實務上較少採用此方法。因此，以市場法做為股價評價之基礎。

2. 承銷價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

(1) 採樣同業之選擇

該公司主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工，包含顯示高壓邏輯製程(High Voltage；主要應用於手機、平板、TV及電子紙等驅動IC及觸控驅動IC等產品)、電源管理晶片產品(Power IC)、分離式元件產品(Discrete)、CMOS影像感測器產品(CIS；CMOS Image Sensor)、嵌入式非揮發性記憶體之晶圓代工服務；以及記憶體產品晶圓代工，包含動態隨機存取記憶體產品(DRAM)、快閃記憶體產品(NAND Flash、NOR Flash)之晶圓代工服務。

檢視目前上市櫃公司，選擇條件以同屬從事半導體晶圓代工服務或記憶體製造之公司，並參酌營業項目較為相近者，選取聯電(上市公司，股票代號：2303)、世界(上櫃公司，股票代號：5347)及華邦電(上市公司，股票代號：2344)作為採樣公司。其中，聯電主要係提供半導體晶圓代工之服務，專注於邏輯及特殊技術，包含電子行業的各項主要應用產品生產晶片；世界主要係提供半導體晶圓代工之服務，包含邏輯、混合訊號、高壓、超高壓、BCD、SOI、嵌入式非揮發性記憶體等製程，主要代工產品為LCD驅動IC、電源管理IC及指紋辨識IC等；華邦電主要從事利基型記憶體IC設計、製造與銷售，產品包括利基型記憶體(Specialty DRAM)、行動記憶體(Mobile DRAM)以及編碼型快閃記憶體(Code Storage Flash Memory)等。

(2) 市場法

A. 該公司財務資料

單位：新臺幣千元；千股

項目	2018年度	2019年度	2020年度	2020年第四季至2021年第三季
本期淨利	6,914,744	(2,643,184)	3,806,477	10,974,822
擬上市掛牌股數				3,535,196
每股盈餘(元)(註)	1.96	(0.75)	1.08	3.10

資料來源：該公司2018~2020年度經會計師查核簽證之財務報告及2021年度第三季經會計師核閱之財務報告。

註：每股盈餘及每股淨值係以擬上市掛牌股數追溯調整計算。

B. 本益比法

單位：新臺幣元

公司	期間	每股盈餘(註2)	平均收盤價	平均本益比(倍)
聯電 (2303)	2021年8月	3.62	59.57	16.46
	2021年9月		66.16	18.28
	2021年10月		59.53	16.44
世界 (5347)	2021年8月	4.98	139.95	28.10
	2021年9月		158.18	31.76
	2021年10月		144.4	29.00
華邦電 (2344)	2021年8月	1.90	31.09	16.36
	2021年9月		28.69	15.10
	2021年10月		25.39	13.36
半導體類股—上市	2021年8月	—	—	25.33
	2021年9月			24.02
	2021年10月			23.73
半導體類股—上櫃	2021年8月	—	—	25.69
	2021年9月			24.51
	2021年10月			25.35

資料來源：臺灣證券交易所及公開資訊觀測站。

註1：平均本益比=平均收盤價/每股盈餘。

註2：每股盈餘係以最近四季稅後純益除以2021年6月30日之股本計算

註3：平均收盤價係以每日收盤價格平均計算。

該公司採樣同業及上市櫃「半導體」類股最近三個月(2021年8月~2021年10月)之平均本益比區間介於13.36~31.76倍之間，若以該公司最近四季之每股盈餘約為3.10元，按上述本益比區間計算，參考價格區間介於41.42~98.46元；並考量該公司經營績效、獲利情形、財務結構、產業未來發展前景及興櫃市場近期股價予以評估後，該公司此次上市與本證券承銷商議定之承銷價格每股新臺幣49.88元尚屬合理。

C. 股價淨值比法

單位：新臺幣元

公司	期間	最近期財報 每股淨值(註2)	平均收盤價	平均股價 淨值比(倍)
聯電 (2303)	2021年8月	19.33	59.57	3.08
	2021年9月		66.16	3.42
	2021年10月		59.53	3.08
世界 (5347)	2021年8月	17.33	139.95	8.08
	2021年9月		158.18	9.13
	2021年10月		144.40	8.33
華邦電 (2344)	2021年8月	19.14	31.09	1.62
	2021年9月		28.69	1.50
	2021年10月		25.39	1.33
半導體類股—上市	2021年8月	—	—	5.82
	2021年9月			5.52
	2021年10月			5.55
半導體類股—上櫃	2021年8月	—	—	5.11
	2021年9月			4.88
	2021年10月			5.1

資料來源：臺灣證券交易所及公開資訊觀測站。

註1：平均股價淨值比=平均收盤價/每股淨值。

註2：每股淨值係以2021年6月30日歸屬於母公司業主之權益除以之股本計算。

註3：平均收盤價係以每日收盤價格平均計算。

採樣同業公司、上市大盤及半導體類股最近三個月之平均股價淨值比介於1.33~9.13倍，以該公司擬以掛牌股數3,535,196千股計算之每股淨值14.75元為基礎計算，價格區間約為19.62~134.67元；惟股價淨值比法使用歷史性財務資料，無法反映公司未來成長性，且較常用於評估獲利波動度較大或有鉅額資產但股價偏低之公司，故本證券承銷商不擬採用此法作為議定承銷價格參考之依據。

(3) 成本法

成本法係為帳面價值法(Book Value Method)，帳面價值乃是投資人對公司請求權價值之總和，包含債權人、普通股投資人及特別股投資人等。其中，股票投資者對公司之請求權價值係公司資產總和扣除負債總額之淨資產價值。此種評價方式係以歷史成本為計算依據，將忽略通貨膨脹因素且無法表達資產實際經濟價值，並深受財務報表採行之會計原則與方法影響，將可能低估成長型公司之企業價值，同時成本法使用上的限制有下列四項，因此國際上慣用成本法以評估企業價值者並不多見：

- 無法表達目前真正及外來之經濟貢獻值。
- 忽略技術經濟壽命。
- 技術廢舊及變革對於其所造成之風險無法預測。
- 成本法中對於折舊項目及金額有量化的困難。

由於上述種種限制，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見，且該公司2021年9月30日經會計師核閱之歸屬母公司業主權益52,157,308千元及擬以掛牌股數3,535,196千股計算之每股淨值為14.75元，與興櫃市場交易價格差異甚大，且成本法並未考量公司成長性，較常用於評估傳統產業類股或衰退型公司，因此本證券承銷商不擬採用此種方法作為承銷價格訂定之參考依據。

(4) 收益法-現金流量折現法

A. 模型介紹

現金流量折現法之理論依據，係認為企業價值應等於未來營運可能創造淨現金流量之現值總和，在多種理論模型中，以自由現金流量折現模式(Free Cash Flow Model)最能反映投資人報酬率，其計算公式如下：

$$P_0 = V_E / N = (V_0 - V_D) / \text{Shares}$$

$$V_0 = \sum_{t=1}^{t=n} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^t} + \sum_{t=n+1}^{t=m} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^n \times (1+K2)^{t-n}} + \frac{FCFF_{m+1}}{(1+K1)^n \times (1+K2)^{m-n} \times (K3 - G)}$$

$$FCFF_t = EBIT_t \times (1 - \text{tax rate}_t) + Dep_t \& Amo_t - Capital Exp_t - \Delta NWC_t$$

$$K_i = \frac{D}{V} \times K_d (1 - \text{tax rate}) + \frac{E}{V} \times K_e$$

$$Ke = \frac{A}{A} Rf + \beta_j (Rm - Rf)$$

P_0	=	每股價值
V_0	=	企業總體價值 = $V_E + V_D$ = 股東權益價值 + 負債價值
N	=	擬上市股數 3,535,196 千股
$FCFF_t$	=	第 t 期之自由現金流量
K_i	=	加權平均資金成本 $i=1, 2, 3$
G	=	營業收入淨額成長率
n	=	5 第一階段之經營年限：2021 年度~2025 年度
m	=	10 第二階段之經營年限：2026 年度~2030 年度
$EBIT_t$	=	第 t 期之息前稅前淨利
$tax\ rate_t$	=	第 t 期之稅率
$Dep_t \& Amo_t$	=	第 t 期之折舊與攤銷費用
$Capital\ Exp_t$	=	第 t 期之資本支出
ΔNWC_t	=	第 t 期之淨營運資金 - 第 t-1 期之淨營運資金 = (第 t 期之流動資產 - 不付息流動負債) - (第 t-1 期之流動資產 - 不付息流動負債)
D/A	=	付息負債資產比
E/A	=	權益資產比 = $1 - D/A$
K_d	=	負債資金成本率
K_e	=	權益資金成本率
R_f	=	無風險利率
R_m	=	市場平均報酬率
β_j	=	系統風險；衡量公司風險相對於市場風險之指標

B. 股東權益資金成本率及自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間 I	期間 II	期間 III	基本假設說明
t	$t \leq n$ $n=5$	$n+1 \leq t \leq m$ $n=5, m=10$	$m+1 \leq t$ $m=10$	依據該公司狀況分為三期間： 期間 I：2021~2025 年度 期間 II：2026~2030 年度 期間 III：2031 年度後(永續經營期)
D/A	41.7537%	40.8768%	40.0000%	預期該公司所屬產業持續成長，未來該公司將繼續穩定發展並持續擴廠，預計該公司除一般借款外，將會由資本市場募集資金，避免提高負債比率，假設公司營運穩定成長，隨著營業活動現金淨流入，營運資金尚為充裕，期間 III 能降至 40%。
E/A	58.2463%	59.1232%	60.0000%	同上。
K_d	1.5394%	1.5394%	1.5394%	因未來市場升息難以預測，且配合財務結構之假設，係以該公司 2018~2020 年度及 2021 年度第三季財務報告之平均借款利率預估未來之負債資金成本率。
$tax\ rate$	20.0000%	20.0000%	20.0000%	以財政部營利事業所得稅率 20% 估計未來之稅率。
R_f	0.5484%	0.5484%	0.5484%	採用 2021 年 9 月 30 日櫃買中心 10 年以上之加權平均公債殖利率。預期 5 年以後之利率將持平。
R_m	9.4790%	9.4790%	9.4790%	係以 2009~2020 年度指數投資報酬率之幾何平均數估計
β_j	1.2996	1.1498	1.0000	採用半導體類指數對上市股票加權指數之平均風險係數估計該公司之系統風險；期間 I 係採用 2018 年度~2021 年第三季證券交易所營業日指數資料之風險係數；期間 III 預期永續經營期之系統風險將逐步貼近市場之系統風險，故假設為 1；期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平均值。
K_e	12.1546%	10.8168%	9.4790%	依上述模型介紹之計算公式得出權益資金成本率。

項目	期間 I	期間 II	期間 III	基本假設說明
K_i	7.7224%	7.0245%	6.3032%	依上述模型介紹之計算公式得出加權平均資金成本。

C.自由現金流量之參數設定及計算結果

(A)保守情境

項目	期間 I	期間 II	期間 III	基本假設說明
G	9.0000%	6.1500%	3.3000%	期間 I 係 IC Insights 預估晶圓代工市場長期年成長率；期間 III 採用國際貨幣基金組織(IMF)發布之預測未來五年(2022~2026 年度)實質 GDP 成長率 3.30%；期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平均值。
$EBIT_t / Sales_t$	18.7447%	18.7447%	18.7447%	採用該公司過去三年度(2018~2020 年度)及 2021 年前三季平均息前稅前淨利率以估計未來之息前稅前淨利。
Dep_t / FA_t	1.9532%	1.9532%	1.9532%	採用該公司過去三年度(2018~2020 年度)及 2021 年前三季平均折舊費用占折舊資產比率以估計未來之折舊攤銷費用。
$Capital Exp_t / Sales_t$	34.1565%	3.0000%	2.0000%	期間 I 依 P5 廠建廠計畫預計投入金額占未來營收之比率，期間 II、期間 III 依未來資本支出計畫暫估。
$\Delta NWC_t / Sales_t$	4.4142%	4.4142%	4.4142%	採用該公司過去三年度(2018~2020 年度) 2021 年前三季平均淨營運資金占營業收入比率以估計未來之淨營運資金。

(B)樂觀情境

項目	期間 I	期間 II	期間 III	基本假設說明
G	16.0000%	9.6500%	3.3000%	期間 I 係 IC Insights 預估晶圓代工市場 2021 年成長率；期間 III 採用國際貨幣基金組織(IMF)發布之預測未來五年(2022~2026 年度)實質 GDP 成長率 3.30%；期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平均值。
$EBIT_t / Sales_t$	18.7447%	18.7447%	18.7447%	採用該公司過去三年度(2018~2020 年度)及 2021 年前三季平均息前稅前淨利率以估計未來之息前稅前淨利。
Dep_t / FA_t	1.9532%	1.9532%	1.9532%	採用該公司過去三年度(2018~2020 年度)及 2021 年前三季平均折舊費用占折舊資產比率以估計未來之折舊攤銷費用。
$Capital Exp_t / Sales_t$	34.1565%	3.0000%	2.0000%	期間 I 依 P5 廠建廠計畫預計投入金額占未來營收之比率，期間 II、期間 III 依未來資本支出計畫暫估。
$\Delta NWC_t / Sales_t$	4.4142%	4.4142%	4.4142%	採用該公司過去三年度(2018~2020 年度) 2021 年前三季平均淨營運資金占營業收入比率以估計未來之淨營運資金。

D.每股價值之計算

(A)保守情境

$$\begin{aligned}
 P_0 &= (V_0 - V_D) / Shares \\
 &= (189,457,924 \text{ 千元} - 23,111,595 \text{ 千元}) / 3,535,196 \text{ 千股} \\
 &= 47.05 \text{ 元/股}
 \end{aligned}$$

(B)樂觀情境

$$\begin{aligned}
 P_0 &= (V_0 - V_D) / Shares \\
 &= (306,709,257 \text{ 千元} - 23,111,595 \text{ 千元}) / 3,535,196 \text{ 千股} \\
 &= 80.22 \text{ 元/股}
 \end{aligned}$$

該公司依自由現金流量折現法保守情境及樂觀情境之參數假設及計算公式，計算其參考價格區間為 47.05~80.22 元。雖暫訂承銷價 49.88 元落於該價格區間內，惟此法主要係以未來各期創造現金流量之折現值合計認為股東權益價值，然因未來之現金流量無法精確掌握，評價方法所使用之相關參數，如未來營收成長率、資本支出之假設多採用過去歷史經驗預估。在永續經營假設下，產業快速變化之特性使對未來之預估更具不確定性，較無法合理評估公司應有之價值，故對未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握，且相關參數之參考價值亦相對較為主觀，本次承銷價格訂定不擬採用此方法評估。

(二)該公司與已上市同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

茲就該公司與採樣同業公司聯電、世界及華邦電之財務狀況、獲利情形及本益比之比較分析列示如下：

1.財務狀況

單位：%；次；每股元

評估項目	公司	年度				
		2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年截至 第三季	
財務結構	負債占資產比率(%)	力積電	55.78	59.29	57.91	51.01
		聯電	43.35	44.02	37.55	39.92
		世界	21.81	30.99	32.32	41.11
		華邦電	33.48	39.07	43.99	40.97
		同業	44.50	45.40	46.40	
	長期資金占不動產、 廠房及設備比率(%)	力積電	120.23	121.44	129.77	172.35
		聯電	182.07	197.82	225.40	273.86
		世界	472.74	236.34	238.59	213.17
		華邦電	151.61	153.20	163.65	187.02
		同業	209.21	187.62	198.41	
償債能力	流動比率(%)	力積電	119.47	112.22	123.19	214.20
		聯電	282.96	211.45	209.99	250.28
		世界	358.91	190.60	194.35	210.62
		華邦電	227.86	214.42	186.58	222.06
		同業	172.40	163.20	166.40	
	速動比率(%)	力積電	79.32	67.79	76.71	172.90
		聯電	223.98	172.94	178.20	220.34
		世界	309.13	160.81	165.96	180.42
		華邦電	161.63	155.43	131.07	168.36
		同業	135.90	130.70	132.30	
	利息保障倍數(倍)	力積電	17.36	(3.51)	7.65	22.65
		聯電	1.79	2.96	14.93	30.98
		世界	0.00	179.74	114.75	277.54
		華邦電	33.46	5.36	4.47	36.06
		同業	1,339.4	940.70	4,444.70	
經營能力	應收款項週轉率(次) (註1)	力積電	8.50	6.10	7.86	7.99
		聯電	6.59	5.89	6.56	6.77
		世界	5.90	5.29	6.19	6.13
		華邦電	7.55	7.53	7.43	6.31
		同業	4.90	5.00	5.40	
	存貨週轉率(次) (註1)	力積電	5.39	5.01	4.88	4.60
		聯電	7.04	6.36	6.23	6.12
		世界	6.05	5.50	7.08	7.03
		華邦電	3.36	3.38	3.57	3.88
		同業	7.20	7.10	7.10	
	不動產、廠房及設備週轉率 (次)	力積電	1.32	0.82	0.97	1.27
		聯電	0.80	0.92	1.25	1.59
		世界	4.56	2.85	2.46	2.56
		華邦電	1.06	0.89	1.02	1.62
		同業	3.10	2.70	2.70	
總資產週轉率(次)	力積電	0.81	0.51	0.60	0.66	
	聯電	0.40	0.40	0.47	0.51	

單位：%；次；每股元

評估項目	年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年截至 第三季
	公司				
	世界	0.80	0.70	0.77	0.85
	華邦電	0.56	0.49	0.53	0.74
	同業	0.90	0.90	0.90	

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比率。

註 1：應收帳款週轉率係以總額計算；存貨週轉率係以淨額計算。

(1)財務結構

A.負債占資產比率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之負債占資產比率分別為 55.78%、59.29%、57.91% 及 51.01%，主係該公司基於營運策略考量，於 106 年購入竹南廠及生產設備以擴充產線，並向銀行申請聯貸案，使得負債比率整體偏高；2019 年度負債占資產比率較 2018 年度上升，主係竹南廠進行第二階段擴建專案，向銀行申請聯貸案所致；2020 年度負債占資產比率下降，係因該公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營運資金增加所致；2021 年第三季負債占資產比率較 2020 年度下降，主係該公司於 2021 年第一季辦理現金增資且收足股款，使得負債比率整體下降。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季負債占資產比率高於採樣公司及同業平均，主係因晶圓製造是一個高資本投入的行業，每年都會有資本支出計畫，在維護設備運作、既有產能去瓶頸化投資、或是建新廠，每家公司的產能建置狀況不同，所以每年度的不動產、廠房及設備投資金額也會有所差異，最近三年度及最近期該公司持續擴大營運，向銀行申請聯貸，投入大量資金興建竹南廠及生產設備以擴充產線，故該等比較差。惟隨該公司於 2021 年第一季辦理第一次現金增資，於 2021 年 6 月 11 日收足股款，並訂為現金增資基準日，2021 年第三季財務報告負債比率隨之下降，尚無重大異常之情事。

B.長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 120.23%、121.44%、129.77% 及 172.35%，2019 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因擴建竹南廠增加長期銀行借款及租賃土地適用 IFRS 16 使用權資產之會計處理，租賃負債增加等使長期資金增加所致；2020 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因該公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、盈餘獲利使淨值提升所致；2021 年第三季長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利使淨值提升，且該公司為營運需求，向銀行增加借款所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，由於該公司積極擴建產能，不動產、廠房及設備金額自 2019 年躍升為 474 億元後，持續維持在 470 多億或近 470 億元，再加上未來銅鐳 P5 的建廠計畫，未來會隨著驗收進度，持續增加不動產、廠房及設備金額。2018~2020 年度及 2021 年第三季長期資金占不動產、廠房及設備比率雖低於採樣公司及同業平均，惟該等比率大於 100%，顯示該公司長期資金尚足以支應營運所需之不動產、廠房及設備支出，且已逐年改善，2021 年 6 月已完成總籌資金額 120 億元的增資案，再加上未來上市前現增可募集金額，將可大幅提高該比率，拉近與同業間的距離，尚無重大異常情事。

整體而言，該公司最近三年度及最近期之財務結構在營業規模逐漸成長及獲利挹注之下尚屬穩定，經評估應無重大異常之情事。

(2)償債能力

A.流動比率及速動比率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之流動比率分別為 119.47%、112.22%、123.19% 及 214.20%，速動比率分別為 79.32%、67.79%、76.71% 及 172.90%，速動比率與流動比率變動趨勢相似，其 2019 年度流動比率及速動比率較 2018 年度低，主係該公司於 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入較 2018 年度下降 28.08%，帳上現金及應收帳款下降，使得流動資產及速動資產減少；2020 年度流動比率及速動比率較 2019 年度高，係因該公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，再加上當年度的資本支出規模較低，使得營業活動淨現金流入已足以支應投資活動及籌資活動的淨現金流出，故使流動資產項目中現金、應收帳款及存貨等皆較 2019 年度增加所致；2021 年第三季流動比率及速動比率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營業收入增加，盈餘獲利使得營業活動淨現金流入，且該公司為營運需求，向銀行增加借款，另該公司於 2021 年第一季辦理現金增資並於第二季收足股款使得現金增加，綜上所述，帳上現金增加及應收帳款增加，使得流動資產及速動資產增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，2018~2020 年度該公司流動比率及速動比率低於採樣公司及同業平均，2021 年第三季則介於採樣公司間，主係因由於該公司當初受讓力晶公司 12 吋晶圓製造相關營業資產與負債，連帶亦承接當初銀行團的聯貸契約，所以仍有部分歷史包袱需要再還，隨著業績狀況轉佳，公司已一步一步調整好財務體質，相關比率也越來越好，惟流動比率大於 100%。且隨該公司於 2021 年第一季辦理第一次現金增資並於第二季收足股款，帳上現金增加，顯示該公司流動資產尚足以支應營運所需之流動負債，且該等比率 2020 年度及 2021 年第三季已隨營收成長逐步提升，償債能力尚屬穩健，經評估其流動比率及速動比率之變化應無重大異常情事。

B.利息保障倍數

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之利息保障倍數分別為 17.36 倍、(3.51)倍、7.65 倍及 22.65 倍，2019 年度利息保障倍數較 2018 年低且為負數，主係該公司於 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，當年度營業收入相較 2018 年度下降，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 2019 年度處於虧損所致；2020 年度利息保障倍數增加，係因該公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利所致；2021 年第三季利息保障倍數增加，係因半導體需求熱絡，該公司產品銷售價格上升、銷售數量增加，營收成長、

盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，2019 年度華邦電及同業平均水準之利息保障倍數亦較 2018 年度下滑，惟該公司利息保障倍數皆低於採樣公司及同業平均水準，主係因 2019 年受貿易紛爭干擾，全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振，導致記憶體價格下跌，該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，受到記憶體價格下跌影響較鉅，且該公司驅動 IC 產品新舊技術平台轉換，綜上所述造成 2019 年度產生虧損，而使得利息保障倍數低；2018 及 2020 年度利息保障倍數均介於採樣公司及同業間。2021 年第三季利息保障倍數低於採樣公司，主係因 2021 年資本支出舉借長期借款，故造成利息費用增加，導致利息保障倍數增加幅度未若同業，惟該比率已自 2020 年度起逐年改善。整體而言，該公司之償債能力尚屬無虞，與同業相較尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司最近三年度及最近期之償債能力各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

(3)經營能力

A.應收款項週轉率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之應收款項週轉率分別為 8.50 次、6.10 次、7.86 次及 7.99 次，2019 年度應收帳款週轉率下降，主係 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 2018 年度下降 28.08%，營業收入減少幅度高於平均應收款項總額減少幅度之故；2020 年應收款項週轉率上升，係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致；2021 年第三季應收款項週轉率略為上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長，較 2020 年度增加所致。整體而言，該公司之往來客戶多為國內外知名大廠，營運規模、財務狀況及長期往來信用良好，帳款品質穩定，且最近三年度及最近期並無實際發生呆帳損失，並無重大異常情事。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 2018 年度、2020 年度及 2021 年第三季應收款項週轉率均優於採樣同業及同業平均，2019 年度應收款項週轉率介於採樣同業之間，採樣同業間應收款項週轉情形差異主係因各公司之營運規模、收款政策及客戶組成不同所致，應無重大異常之情事。

B.存貨週轉率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之存貨週轉率分別為 5.39 次、5.01 次、4.88 次及 4.60 次，該公司係以接單式生產及計畫性生產兼具之生產方式安排生產排程及採購作業，以供應已承接訂單及長久穩定往來主要客戶之需求，存貨週轉率主要受到因訂單排程及客製化產品須提前備料，因而略有增減。2019 年度存貨週轉率較 2018 年度下降，主係 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 2018 年度下降，使相對的銷貨成本減少所致；而 2020 年度存貨週轉率下降，則主係隨著邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，2020 年底為因應 2021 年度訂單需求故增加原料備貨，2020 年存貨淨額提升所致；2021 年第三季存貨週轉率略為下降，係因半導體需求熱絡，為因應訂單需求故持續增加原料備貨，使平均存貨較 2020 年度平均存貨增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之存貨週轉率介於採樣公司及同業平均水準間，主係該公司記憶體產品之晶圓生產所需時間長於邏輯代工產品，故採樣同業相較之下低於邏輯代工同業如聯電與世界、高於記憶體同業華邦電，整體而言尚無重大異常情事。

C.不動產、廠房及設備週轉率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 1.32 次、0.82 次、0.97 次及 1.27 次，2019 年度不動產、廠房及設備週轉率較 2018 年度下降，係因 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 2018 年度下降，且擴建竹南廠增加資本支出，使平均不動產、廠房及設備淨額較 2018 年增加所致；2020 年度不動產、廠房及設備週轉率上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致，其營收成長幅度大於該年度之平均不動產、廠房及設備之幅度所致；2021 年第三季不動產、廠房及設備週轉率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 2018 年度不動產、廠房及設備週轉率介於採樣公司及同業平均，2019 年度華邦電及同業平均水準之不動產、廠房及設備週轉率亦較 2018 年度下滑，惟該公司不動產、廠房及設備週轉率皆低於採樣公司及同業平均水準，主係因 2019 年受貿易紛爭干擾，全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振，導致記憶體價格下跌，該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，受到記憶體價格下跌影響較鉅，綜上所述造成 2019 年度營收下滑，而使得不動產、廠房及設備週轉率低；2020 年度及 2021 年第三季不動產、廠房及設備週轉率低於採樣公司及同業平均水準，主係因該公司持續擴大營運，投入大量資金興建竹南廠及生產設備以擴充產線，故造成固定資產淨額較高，惟在營運持續暢旺下，該公司於 2020 年度不動產、廠房及設備週轉率逐漸提升。整體而言，該公司產品別與華邦電相似，同時具有邏輯產品及記憶體產品，使得 2018~2020 年度不動產、廠房及設備週轉率與華邦電相當，尚無重大異常之情事。

D.總資產週轉率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之總資產週轉率分別為 0.81 次、0.51 次、0.60 次及 0.66 次。2019 年度總資產週轉率皆較 2018 年度下降，係因 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願致營業收入減少，且擴建竹南廠增加資本支出，使平均不動產、廠房及設備淨額較 2018 年增加；2020 年度因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致，其營收成長幅度大於該年度之平均總資產之幅度所致；2021 年第三季總資產週轉率上升，係因半導體需求熱絡，該公司產品銷售價格上升、銷售數量增加，營收成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司總資產週轉率 2018~2020 年度及 2021 年第三季皆介於採樣公司及同業平均，尚無重大異常之情事。

2.獲利能力

評估項目	年度		2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年截至 第三季
	公司	力積電				
獲	權益報酬率(%)	力積電	23.37	(8.83)	12.07	30.90

評估項目	公司	年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年截至 第三季
利 能 力	聯 電		1.26	2.96	12.27	21.14
		世 界	21.52	19.88	21.34	35.30
		華邦電	12.31	2.31	2.26	17.84
		同 業	14.10	10.40	14.90	
		力積電	247.77	(6.76)	18.50	49.15
	營業利益占實收資本額比率 (%)	聯 電	4.67	3.99	17.72	36.57
		世 界	43.65	42.16	45.25	77.31
		華邦電	19.92	3.15	4.09	43.10
		同 業	註 1	註 1	註 1	
		力積電	240.89	(8.42)	15.45	46.33
	稅前純益占實收資本額比率 (%)	聯 電	1.76	4.88	22.48	46.83
		世 界	45.59	44.90	46.17	78.55
		華邦電	21.09	4.40	4.55	42.44
		同 業	註 1	註 1	註 1	
		力積電	13.85	(7.36)	8.33	21.57
	純益率(%)	聯 電	1.75	4.14	15.37	25.41
		世 界	21.32	20.72	19.03	25.96
		華邦電	15.10	3.03	2.50	13.97
		同 業	8.10	6.40	9.00	
		力積電	2.56	(0.94)	1.23	3.07
每股稅後盈餘(元) (註 2)	聯 電	0.58	0.82	2.42	3.26	
	世 界	3.76	3.58	3.85	4.94	
	華邦電	1.87	0.32	0.33	2.36	
	同 業	註 1	註 1	註 1		

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比率。

註 1：「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益占實收資本額比率、稅前純益占實收資本額比率及每股稅後盈餘。

註 2：每股稅後盈餘係以基本每股盈餘作揭露。

(1) 權益報酬率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之權益報酬率分別為 23.37%、(8.83)%、12.07% 及 30.90%，2019 年度股東權益報酬較 2018 年度低且為負數，係因 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少且公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 2019 年度處於虧損所致；2020 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故權益報酬率由負轉正；2021 年第三季權益報酬率增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司權益報酬率 2018 年度高於採樣公司及同業平均，2019 年度華邦電及同業平均水準之權益報酬率亦較 2018 年度下滑，惟該公司低於採樣公司及同業平均，主係因該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 2019 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 2019 年度產生虧損所致；2020 年度及 2021 年第三季介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈權益報酬率逐漸上升，顯示該公司為股東創造利潤之能力尚稱良好，經評估其權益報酬率之變化應無重大異常情事。

(2) 營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之營業利益占實收資本額比率分別為 247.77%、(6.76)%、18.50% 及 49.15%；稅前純益占實收資本額比率分別為 240.89%、(8.42)%、15.45% 及 46.33%，2018 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率較高，係因該公司於 2019 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組，收購力晶科技股份有限公司(以下簡稱力晶科)12 吋晶圓廠相關資產負債，並發行新股予力晶科作為取得對價，此交易係屬於共同控制下的組織重組，應追溯視為自始合併並重編比較期間之合併報告，於 2018 年度業經重編後的營業淨利及稅前純益係涵蓋受讓業務，然 2018 年度實收資本額則未改變仍為未併購前金額，致使該比率有較大差異；2019 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率為負數，係因 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 2019 年度處於虧損所致；2020 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率皆由負轉正；2021 年第三季營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司相較，該公司營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率，2018 年度高於採樣公司，2019 年度華邦電之營

業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率亦較 2018 年度下滑，惟該公司低於採樣公司，主係因該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 2019 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 2019 年度產生虧損所致；2020 年度及 2021 年第三季介於採樣公司，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司之獲利能力良好且逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

(3)純益率及每股稅後盈餘

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之純益率分別為 13.85%、(7.36)%、8.33%及 21.57%；每股稅後盈餘分別為 2.56、(0.94)、1.23 及 3.07，2019 年度純益率及每股稅後盈餘較 2018 年度低且為負數，係因 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，致 2019 年度處於虧損；2020 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故純益率及每股稅後盈餘皆由負轉正；2021 年第三季純益率及每股稅後盈餘增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司純益率及每股稅後盈餘，2019 年度華邦電之純益率及每股稅後盈餘亦較 2018 年度下滑，惟該公司低於採樣公司及同業平均，主係因該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 2019 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 2019 年度產生虧損所致；2018 年度、2020 年度及 2021 年第三季之純益率及每股稅後盈餘介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司之獲利能力良好且逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

3.本益比

請參閱本前述「二、(一)、2、(2)、B 本益比法」之評估說明。

(三)所議定之承銷價格若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本次承銷價格之議訂並無採取專家意見或鑑價報告，故不適用。

(四)發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

該公司於 2021 年 12 月 9 日於興櫃市場掛牌，最近一個月（2021 年 10 月 22 日~2021 年 11 月 21 日）之月平均股價及成交量分別為 71.32 元及 445,690 千股。

(五)證券承銷商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

本證券承銷商經考量該公司之獲利能力、產業未來發展前景及初次上市股票流動性等因素，並參酌採樣同業公司及上市類股之本益比，以及該公司最近一個月興櫃市場之平均成交價，作為該公司辦理股票承銷之參考價格訂定依據。復參酌該公司所處產業、市場地位、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本證券承銷商與該公司共同議定之。該公司初次上市前現金增資案採競價拍賣之承銷方式，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 8 條規定，設算向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日（2021 年 9 月 29 日~2021 年 11 月 10 日）其成交均價扣除無償配股（或減資除權）及除息後簡單算術平均數 65.27 元之七成（45.69 元）為上限，爰訂定最低承銷價格（競價拍賣底標）為 43 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；另依同法第 17 條規定，公開申購承銷價格以各得標單之價格及數量加權平均所得價格新台幣 63.52 元為之，惟該均價高於最低承銷價格之 1.16 倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣 49.88 元溢價發行，尚屬合理。

發行公司：力晶積成電子製造股份有限公司	代表人：黃崇仁
主辦證券承銷商：元大證券股份有限公司	代表人：陳修偉
協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司	代表人：黃進明
群益金鼎證券股份有限公司	代表人：王濬智
兆豐證券股份有限公司	代表人：陳佩君
第一金證券股份有限公司	代表人：陳致全
台新綜合證券股份有限公司	代表人：郭嘉宏
元富證券股份有限公司	代表人：陳俊宏
合作金庫證券股份有限公司	代表人：謝政雄
台灣土地銀行股份有限公司	代表人：謝娟娟
彰化商業銀行股份有限公司	代表人：凌忠嫻

【附件二】律師法律意見書

力晶積成電子製造股份有限公司本次為募集與發行新股 130,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，發行總金額為新台幣 1,300,000,000 元整，向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，力晶積成電子製造股份有限公司本次向臺灣證券交易所股份有限公司提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

傑宇法律事務所 陳維鈞律師

【附件三】證券承銷商評估報告總結意見

力晶積成電子製造股份有限公司(以下簡稱力積電或該公司)本次為辦理初次上市現金增資發行普通股 130,000 仟股，每股面額新台幣壹拾元整，發行總額為新台幣 1,300,000 仟元整，依法向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解該公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，力積電本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉

承銷部門主管：林佩宸